

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**深圳市明微电子股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市**

**之**

**发行保荐书**

**保荐机构**



**二〇二〇年四月**

## 保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人龙敏、余皓亮根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

## 目 录

释 义 .....	3
<b>第一节 本次证券发行基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 .....	5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 .....	5
三、发行人基本情况 .....	6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 .....	7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 .....	7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 .....	9
<b>第二节 保荐机构承诺事项 .....</b>	<b>11</b>
<b>第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .....</b>	<b>15</b>
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 .....	15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 .....	15
<b>第四节 对本次发行的推荐意见 .....</b>	<b>17</b>
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 .....	17
二、本次发行符合相关法律规定 .....	17
三、发行人的主要风险提示 .....	22
四、发行人的发展前景评价 .....	30
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 .....	30

## 释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通术语		
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
明微电子、发行人、公司	指	深圳市明微电子股份有限公司
明微技术	指	深圳市明微技术有限公司，发行人控股股东
明微香港	指	明微电子（香港）有限公司，公司全资子公司
德清红树林	指	德清红树林投资咨询合伙企业（有限合伙）
发行人律师	指	广东华商律师事务所
发行人会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《内控报告》	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0019号）
《审计报告》	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2020]518Z0012号）
本发行保荐书	指	中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
股票、A股	指	境内上市人民币普通股
本次发行	指	本次发行人向社会公众首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的行为
报告期各期末	指	2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
二、专业术语		
集成电路、芯片、IC	指	一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
集成电路设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体版图物理数据的过程
集成电路布图设计、版图设计	指	又称布图设计，集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成晶圆制造厂商加工生产所需要的版图连线图形的设计过程

LED	指	发光二极管 (Light Emitting Diode) 其核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片, 在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层, 称为 PN 结。在半导体材料的 PN 结中, 注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余能量以光的形式释放出来, 从而把电能直接转换为光能
晶圆	指	又称 wafer, 是硅半导体集成电路制作所用的硅晶片, 由于其形状为圆形, 故称为晶圆; 在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构, 使其成为有特定电性功能的 IC 产品
封装	指	把晶圆上的硅片电路, 用导线及各种连接方式, 加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程

注: 本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入原因所致

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定龙敏、余皓亮担任本次明微电子首次公开发行股票并在科创板上市发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

龙敏女士：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：铭普光磁首次公开发行股票并上市项目、英可瑞首次公开发行股票并在创业板上市项目、科士达首次公开发行股票并上市项目、国科控股非公开发行可交换公司债券项目、天润控股非公开发行股票项目、乾照光电非公开发行股票项目、海印股份资产证券化项目等，还参与了耐威科技改制辅导、雷柏科技改制辅导项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：中金岭南公开发行可转换公司债券项目。

余皓亮先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：卓易信息首次公开发行股票并在科创板上市项目、龙福环能首次公开发行股票并上市项目、中盟科技首次公开发行股票并上市项目、海峡股份发行股份购买资产项目、泛谷药业新三板挂牌项目等。

### 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

#### （一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为张莉，其保荐业务执行情况如下：

张莉女士：硕士研究生学历，准保荐代表人、注册会计师，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾参与的主要项目有：华特股份科创板首次公开发行股票并上市项目、福星股份非公开发行股票项目、立高股份首次公开发行股票项目、宇星新材新三板项目、广州检验检测和华声在线上市改制项目、宝龙股份及敏华控股财务顾问项目等。

#### （二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括黄灿泽、马鹏程、方英健。

黄灿泽先生：硕士研究生学历，准保荐代表人、注册会计师、法律职业资格、税务师，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：中国电器首次公开发行股票并在科创板上市项目、铭普光磁首次公开发行股票并上市项目、雅迅网络首次公开发行股票并上市项目、佳都科技非公开发行股票项目、福星股份非公开发行股票及非公开发行公司债券项目、国科控股非公开发行可交换公司债券项目等。

马鹏程先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾参与的主要项目有：中国南网综合能源首次公开发行股票项目、中国泛海集团财务顾问项目、罗麦科技财务顾问项目等。

方英健先生：硕士研究生学历，准保荐代表人、注册会计师，现任中信建投证券投资银行部经理，曾经参与的主要项目有：铭普光磁首次公开发行股票并上市项目、中金岭南公开发行可转换公司债券项目、国科控股非公开发行可交换公司债券项目等。

### 三、发行人基本情况

发行人名称	深圳市明微电子股份有限公司
英文名称	SHENZHEN SUNMOON MICROELECTRONICS CO.,LTD.
注册资本	5,577.60 万元
法定代表人	王乐康
有限公司成立日期	2003 年 10 月 30 日
股份公司设立日期	2008 年 01 月 31 日
公司住所及办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层
董事会秘书	郭王洁
联系电话	0755-26983905
互联网地址	www.chinaasic.com
主营业务	主要从事集成电路的研发、设计、封装测试和销售，产品主要包括 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域
本次证券发行的类型	首次公开发行股票并在科创板上市

#### 四、保荐机构与发行人关联关系的说明

(一)截至本发行保荐书出具日,除保荐人将根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定,安排相关子公司参与本次发行战略配售之外,保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(二)截至本发行保荐书出具日,发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(三)截至本发行保荐书出具日,保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况;

(四)截至本发行保荐书出具日,保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况;

(五)截至本发行保荐书出具日,保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

#### 五、保荐机构内部审核程序和内核意见

##### (一) 保荐机构关于本项目的内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会、上海证券交易所推荐本项目前,通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制,履行了审慎核查职责。

##### 1、项目的立项审批

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定,对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于2019年10月17日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

##### 2、投行委质控部的审核



本保荐机构在投资银行业务委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

2019年12月2日至2019年12月4日，投行委质控部对本项目进行了现场检查。本项目的项目负责人于2020年3月9日向投行委质控部提出底稿验收申请；2020年3月10日至2020年3月20日，受新冠疫情的影响，投行委质控部对本项目采取了远程查阅工作底稿、问核等方式进行核查，并对发行人控股股东和实际控制人王乐康进行了视频访谈，于2020年3月30日对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

### 3、内核部门的审核

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于2020年4月2日发出本项目内核会议通知，内核委员会于2020年4月9日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。

参加本次内核会议的内核委员共7人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、上海证券交易所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了发行保荐书，决定向中国证监会、上海证券交易所正式推荐本项目。

## （二）保荐机构关于本项目的内核意见

本次发行申请符合《证券法》、中国证监会相关法规规定以及上海证券交易所的有关业务规则的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会、上海证券交易所推荐。

## 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查

### （一）核查对象

《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条规定：“本办法所称私募投资基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”；“非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用本办法。”

本次核查对象为发行人的机构股东。截至本发行保荐书出具之日，发行人机构股东为明微技术、德清红树林。

### （二）核查方式

本保荐机构查阅了明微技术的工商登记资料、营业执照、公司章程、财务报表等文件材料，登录全国企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会信息公示网站，通过核查，明微技术系由明微电子实际控制人王乐康、夏春芬、梁宇虹、黄学良于 2007 年 5 月 22 日在深圳市设立的持股平台，其以自有资金通过受让员工股权的方式取得明微电子股份，没有对外公开或非公开募集投资基金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，也不存在以私募股权投资基金受让明微电子股份的情形，因此不需要根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定办理登记、备案。

本保荐机构查阅了德清红树林的合伙协议、营业执照等文件材料，登录全国企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会信息公示网站，通过核查，德清红树林为 2012 年 11 月 28 日在浙江省湖州市设立的有限合伙企业，目前股东为刘晓松、陈章银、张巍、翟晓慧、朱美姿、刘珊珊、李少弘、徐文辉，其以自有资金受让明微电子股份，没有对外公开或非公开募集投资基金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，也不存在以私募股权投资基金受让明微电子股份的情

形，因此不需要根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定办理登记、备案。

### **（三）核查结果**

经核查，本保荐机构认为：发行人 2 名机构股东均不存在基金管理人依据授权进行投资的情形，且不存在设立私募投资基金从事基金管理人的计划，均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募股权投资基金备案或私募股权投资基金管理人登记。

## 第二节 保荐机构承诺事项

一、中信建投证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定以及上海证券交易所的有关业务规则，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐明微电子本次首次公开发行股票并在科创板上市，并据此出具本发行保荐书。

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

三、中信建投证券按照《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14号）和《关于做好首次公开发行

股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551 号）的要求，严格遵守现行各项执业准则和信息披露规范，勤勉尽责、审慎执业，对发行人报告期内财务会计信息的真实性、准确性、完整性开展全面自查，针对可能造成粉饰业绩或财务造假的 12 个重点事项进行专项核查，同时采取切实有效的手段核查主要财务指标是否存在重大异常，并以必要的独立性走访相关政府部门、银行、重要客户及供应商。

中信建投证券就上述财务专项核查工作的落实情况，作出以下专项说明：

（一）通过财务内部控制情况自查，确认发行人已经建立健全财务报告内部控制制度，合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率和效果；

（二）通过财务信息披露情况自查，确认发行人财务信息披露真实、准确、完整地反映公司的经营情况；

（三）通过盈利增长和异常交易情况自查，确认发行人申报期内的盈利情况真实，不存在异常交易及利润操纵的情形；

（四）通过关联方认定及其交易情况自查，确认发行人及各中介机构严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定进行关联方认定，充分披露了关联方关系及其交易；

（五）通过收入确认和成本核算情况自查，确认发行人结合经济交易的实际情况谨慎、合理地进行收入确认，发行人的收入确认和成本核算真实、合规，毛利率分析合理；

（六）通过主要客户和供应商情况自查，确认发行人的主要客户和供应商及其交易真实；

（七）通过资产盘点和资产权属情况自查，确认发行人的主要资产真实存在、产权清晰，发行人具有完善的存货盘点制度，存货真实，存货跌价准备计提充分；

（八）通过现金收支管理情况自查，确认发行人具有完善的现金收付交易制度，未对发行人会计核算基础产生不利影响；

(九) 通过可能造成粉饰业绩或财务造假的 12 个重点事项自查，确认如下：

- 1、发行人不存在以自我交易的方式实现收入、利润的虚假增长；
- 2、发行人不存在发行人或其关联方与其客户或供应商以私下利益交换等方法进行恶意串通以实现收入、盈利的虚假增长；
- 3、发行人不存在发行人的关联方或其他利益相关方代发行人支付成本、费用或者采用无偿或不公允的交易价格向发行人提供经济资源；
- 4、发行人不存在发行人的保荐机构及其关联方、PE 投资机构及其关联方、PE 投资机构的股东或实际控制人控制或投资的其他企业在申报期内最后一年与发行人发生大额交易从而导致发行人在申报期内最后一年收入、利润出现较大幅度增长；
- 5、发行人不存在利用体外资金支付货款，不存在少计原材料采购数量及金额，不存在虚减当期成本和虚构利润；
- 6、发行人不存在采用技术手段或其他方法指使关联方或其他法人、自然人冒充互联网或移动互联网客户与发行人（即互联网或移动互联网服务企业）进行交易以实现收入、盈利的虚假增长等；
- 7、发行人不存在将本应计入当期成本、费用的支出混入存货、在建工程等资产项目的归集和分配过程以达到少计当期成本费用的目的；
- 8、发行人不存在压低员工薪金、阶段性降低人工成本粉饰业绩；
- 9、发行人不存在推迟正常经营管理所需费用开支，不存在通过延迟成本费用发生期间增加利润和粉饰报表；
- 10、发行人不存在期末对欠款坏账、存货跌价等资产减值可能估计不足；
- 11、发行人不存在推迟在建工程转固时间或外购固定资产达到预定使用状态时间等，不存在延迟固定资产开始计提折旧时间；
- 12、发行人不存在其他可能导致公司财务信息披露失真、粉饰业绩或财务造假的情况。

(十)通过未来期间业绩下降信息披露情况自查，确认发行人对于存在未来期间业绩下降情形的，已经披露业绩下降信息风险。

经过财务专项核查，本保荐机构认为，发行人的财务管理、内部控制、规范运作等方面制度健全，实施有效，报告期财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计信息真实、准确、完整，如实披露了相关经营和财务信息。

### 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

#### 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

#### 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。发行人还聘请了深圳深投研顾问有限公司、楊漢源林炳坤律师事务所、深圳市英联翻译有限公司，具体情况如下：

##### （一）聘请的必要性

1、深圳深投研顾问有限公司：发行人与其就IPO募投可行性研究报告项目达成合作意向，并签订《服务委托合同》。深圳深投研顾问有限公司就发行人的募投项目完成了可行性研究报告。

2、楊漢源林炳坤律师事务所：发行人聘请其就境外子公司明微香港进行合规审查，楊漢源林炳坤律师事务所就明微香港境外合规事项出具了法律意见书。

3、深圳市英联翻译有限公司：发行人与其就境外合同等资料的翻译服务签订《英联翻译合同》，深圳市英联翻译有限公司就相关文件出具了翻译文件。

##### （二）第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容

1、深圳深投研顾问有限公司：是一家专注国内企业IPO及再融资咨询服务、企业融资顾问服务、企业财务顾问服务的专业研究机构。深圳深投研顾问有限公司主要为发行人撰写本次IPO募投项目可行性研究报告。



2、楊漢源林炳坤律师事务所：是境外法律咨询机构，主要为发行人提供境外法律核查服务，并出具境外法律意见。

3、深圳市英联翻译有限公司：成立于2010年，是具有翻译资质的翻译服务机构，主要为发行人提供合同翻译服务。

### **（三）定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源**

公司与第三方均通过友好协商确定合同价格，资金来源均为自有资金，支付方式均为银行转账。

深圳深投研顾问有限公司服务费用（含税）为人民币30.00万元，截至本发行保荐书签署日，已支付了14万元。

楊漢源林炳坤律师事务所服务费用（含税）为港币1.70万元，截至本发行保荐书签署日，已完全支付了相关金额。

深圳市英联翻译有限公司服务费用（含税）为人民币546元，截至本发行保荐书签署日，已完全支付了相关金额。

经本保荐机构核查，发行人相关聘请行为合法合规。

## 第四节 对本次发行的推荐意见

中信建投证券接受发行人委托，担任其本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。本保荐机构遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，对发行人进行了审慎调查。

本保荐机构对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价，对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了内部审核程序并出具了内核意见。

本保荐机构内核部门及保荐代表人经过审慎核查，认为发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、政策规定的有关首次公开发行的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐发行人本次发行。

### 一、发行人关于本次发行的决策程序合法

2020年3月26日，发行人召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

2020年4月11日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，本保荐机构认为发行人已就本次发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定以及上海证券交易所的有关业务规则的决策程序。

### 二、本次发行符合相关法律规定

#### （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件

本保荐机构对发行人本次首次公开发行股票并上市是否符合《证券法》规定

的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

### 1、发行人具备健全且运行良好的组织机构

本保荐机构查阅了发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度文件、三会文件、发行人会计师出具的《内控报告》等资料。经核查，发行人已建立起由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司法人治理架构，并在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，按照自身生产经营管理的需要设置了职能部门，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

### 2、发行人具有持续经营能力

本保荐机构查阅了业务合同、发行人会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，报告期内，发行人营业收入分别为 40,624.43 万元、39,106.89 万元和 46,290.21 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7,858.08 万元、4,811.17 万元和 8,072.45 万元，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

### 3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

本保荐机构查阅了发行人会计师出具的《审计报告》。经核查，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

### 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

本保荐机构对发行人相关人员进行了访谈，并取得了发行人控股股东、实际控制人的承诺，并查询了国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网等网站，同时取得了市场监督管理局、住房公积金管理中心、人力资源和社会保障局、社会保险基金管理局、税务局等政府机关出具的控股股东不存在违法违规行为的证明文件。经核查，发行人及其控股股东、实际控制人

最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

## （二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

本保荐机构对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

### 1、发行人的设立时间及组织机构运行情况

本保荐机构查阅了发行人的工商档案、有关主管部门出具的证明文件、《内控报告》等资料。经核查，确认发行人成立于2003年10月30日，于2008年1月31日整体变更为股份有限公司，自成立以来持续经营并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的有关规定。

### 2、发行人财务规范情况

本保荐机构查阅了发行人财务报告、发行人会计师出具的《审计报告》等相关财务资料，并取得了财务相关的内外部文件。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

### 3、发行人内部控制情况

本保荐机构查阅了发行人会计师出具的《内控报告》等内控资料，并与发行人相关人员进行了访谈。经核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

### 4、发行人资产完整性及人员、财务、机构独立情况

本保荐机构查阅了发行人的业务合同、三会文件、发行人会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

#### 5、业务、控制权及主要人员的稳定性

本保荐机构查阅了发行人三会文件、发行人会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，发行人的主营业务为集成电路的研发设计、封装测试和销售，通过核心技术高质量的科技成果转化，为下游应用领域提供 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片等产品。发行人最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员整体稳定，均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，均为王乐康，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

#### 6、资产权属情况

本保荐机构查阅了发行人重要资产的权属证书、银行征信报告、发行人会计师出具的《审计报告》等资料，并查询了裁判文书网。经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

#### 7、发行人经营合法合规性

本保荐机构查阅了发行人相关业务合同、发行人会计师出具的《审计报告》，并与发行人相关人员进行了访谈，发行人主营业务为集成电路的研发设计、封装测试和销售，通过核心技术高质量的科技成果转化，为下游应用领域提供 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片等产品。根据发行

人的陈述并经查验发行人持有的营业执照、公司章程、有关产业政策，发行人的生产经营符合法律、行政法规，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

#### 8、发行人、控股股东及实际控制人的守法情况

本保荐机构对发行人相关人员进行了访谈，并取得了发行人控股股东、实际控制人的承诺，并查询了国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网等网站，同时取得了市场监督管理局、住房公积金管理中心、人力资源和社会保障局、社会保险基金管理局、税务局等政府机关出具的控股股东不存在违法违规行为的证明文件。经核查，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

#### 9、董事、监事和高级管理人员的守法情况

本保荐机构对发行人相关人员进行了访谈，并取得了发行人董事、监事和高级管理人员分别出具的声明，以及公安局出具的《无犯罪记录证明书》，并查询了中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台。经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

### （三）本次发行符合《科创属性评价指引（试行）》的规定

1、关于发行人符合“最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元”的核查情况

保荐机构查阅发行人与研发相关的内控制度，并对研发费用进行了穿行测试测试，查看了研发项目的立项文件，取得了发行人研发投入明细，对研发人员和财务人员进行了访谈，对研发投入的归集进行了核查。

保荐机构通过访谈了解发行人的收入确认政策，查阅了发行人营业收入明

细,对发行人的客户构成及变动情况进行了分析;查看了主要客户的合同或订单,核查了合同或订单的履行情况,对发行人的主要客户进行了走访和函证;对销售收入执行了穿行测试和截止性测试程序,对主要客户回款情况进行了核查。

经核查,最近三年发行人累计研发投入金额为 10,361.12 万元,累计营业收入金额为 126,021.53 万元,最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 8.22%,符合“最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ,或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$  万元”的指标要求。

## 2、关于发行人符合“形成主营业务收入的发明专利(含国防专利) $\geq 5$ 项”的核查情况

保荐机构查阅了发行人境内外 120 项发明专利相关证书,并对相关证书进行了核验,同时取得了国家知识产权局出具的证明,就相关专利的权属和法律状态进行核查;对发行人是否涉及知识产权诉讼纠纷,发明专利有无权利受限进行了网络搜索及访谈;对发明人拥有的发明专利在主要产品的应用情况进行了访谈,同时查阅了相关发明专利的说明书。

经核查,发行人形成主营业务收入的发明专利数量为 114 项,发行人拥有的发明专利均在有效期限内,不存在权利受限或诉讼纠纷的情形,符合“形成主营业务收入的发明专利(含国防专利) $\geq 5$ 项”的指标要求。

## 3、关于发行人符合“最近一年营业收入金额 $\geq 3$ 亿”的核查情况

保荐机构通过访谈了解发行人的收入确认政策,查阅了发行人营业收入明细,对发行人的客户构成及变动情况进行了分析;查看了主要客户的合同或订单,核查了合同或订单的履行情况,对发行人的主要客户进行了走访和函证;对销售收入执行了穿行测试和截止性测试程序,对主要客户回款情况进行了核查。

经核查,发行人 2019 年营业收入金额为 4.63 亿元,符合“最近一年营业收入金额 $\geq 3$ 亿”的指标要求。

## 三、发行人的主要风险提示

### (一) 技术风险

### 1、技术升级迭代及创新风险

集成电路设计行业系技术密集型行业，升级换代速度快，较强的技术研发实力是行业内公司保持持续竞争力的关键要素之一。为了保持技术领先优势和持续竞争力，公司必须准确地预测相关芯片的技术发展方向及市场发展趋势，并根据预测进行包括对现有技术进行升级换代在内的研发投入。若公司未来不能准确把握相关芯片技术和市场发展趋势，技术升级迭代进度和成果未达预期，或者新技术无法实现产业化，将影响公司产品的竞争力并错失市场发展机会，对公司的持续竞争能力和未来业务发展产生不利影响。

### 2、新产品研发失败风险

报告期内，公司研发费用分别为 3,279.46 万元、3,487.63 万元和 3,594.03 万元，占营业收入的比例分别为 8.07%、8.92%和 7.76%，持续高额的研发费用投入以及较强的研发创新能力，保证了公司能够开发出性能较为领先、符合市场需求的新产品。目前，公司产业布局良好，产品系列丰富，应用领域广泛。随着用户对芯片性能需求的持续提升，晶圆制程工艺不断优化，集成电路设计的复杂程度不断提高，开发成本随之增加。在新产品开发过程中，公司需要投入大量的人力和资金，若新产品开发失败或是开发完成后不符合市场需求，将导致公司前期投入的成本无法收回，对公司经营业绩产生不利影响。

### 3、核心技术泄密风险

集成电路设计行业属于智力和技术密集型产业，对技术和研发储备要求较高。核心技术及与之配套的高端、专业人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。自成立以来，公司对核心技术采取了严格的保密措施，并通过申请专利、集成电路布图设计等方式对核心技术进行了必要的保护。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、专利保护措施不力或核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的竞争力和经营业绩造成不利影响。

### 4、无法持续研发投入风险



集成电路设计企业为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，需进行持续的研发投入。在集成电路产品研发阶段，为了验证设计可行性，必须进行工程流片。而工程流片可能需要经过多次修改、优化设计和验证，才能最终形成市场化产品。随着产品生产制造工艺的提高，流片费用大幅上涨。持续、大规模的研发投入，一直是制约集成电路设计行业发展的重要因素。如果公司没有顺畅的融资渠道，有可能无法进行持续的研发投入，这将会影响公司的研发进程，制约产品的更新换代，对公司的竞争力和经营业绩造成不利影响。

## （二）经营风险

### 1、经营业绩波动的风险

伴随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，公司所处的集成电路设计行业也存在一定程度的行业波动。随着产能的逐渐扩充，集成电路设计企业能获得充足的产能和资源支持，面临较好的发展机遇；而当产能供应过剩后，集成电路设计企业若无法保持技术优势和研发创新能力，将在激烈的市场中处于不利地位，进而对公司的经营业绩造成影响。

此外，公司产品主要应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域，业务发展不可避免地受到下游应用市场和宏观经济波动的影响。随着技术革新和产业升级换代，市场新消费需求不断涌现，公司产品虽然具有广阔的市场空间，但宏观经济的波动，可能影响市场整体的消费需求，放缓下游客户对产品的新购和重置需求，或者公司未来不能及时提供满足市场需求的产品，将导致公司未来业绩存在较大幅度波动的风险。

### 2、经营模式可能带来产能受限、品质控制的风险

公司将集成电路设计成果委托晶圆制造厂制造晶圆，并采用委托加工或自建产线的方式对晶圆进行封装测试，为保证公司产品供应环节的稳定性，公司已与多家具有雄厚实力的晶圆制造厂商和封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系。但在集成电路行业生产旺季，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险以及由此带来的品质控制风险。

### 3、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大材料供应商采购的金额分别 20,361.95 万元、20,832.44 万元和 18,033.64 万元，占当期采购总额的比例分别为 68.22%、66.84% 和 63.19%，供应商集中度较高。

公司将集成电路设计成果委托晶圆制造厂制造晶圆，并采用委托加工或自建产线的方式对晶圆进行封装测试，供应商主要包括晶圆制造厂和封装测试厂。由于行业特性，全球范围内知名晶圆制造和封装测试企业，尤其是晶圆制造厂数量较少。公司从技术先进性、供应稳定性和采购成本等方面考虑，合适的供应商选择较为有限，使得报告期内公司供应商集中度较高。虽然公司已与中芯国际、上海先进、华润上华等主要晶圆制造厂商建立了长期稳定的合作关系，但仍然面临因集成电路市场需求量旺盛、偶发性供应不足或供应商自身原因等因素导致晶圆制造和封装测试厂商无法满足公司需求的风险。

#### 4、原材料及封装加工价格波动风险

报告期内，公司主营业务成本主要由晶圆成本和封装及测试成本构成，合计占比为 97.78%、98.04%和 98.15%、晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。

晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。虽然公司已与中芯国际、上海先进、华润上华等主要晶圆制造厂商建立了长期稳定的合作关系，但如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

公司根据行业内封装厂的特点，从中择优选择性价比较高的封测厂商长期合作，并通过版图设计改进、优化封装测试程序，选择最优封装类型，优化供应链、自建封装测试厂等来降低总体封测成本，但目前委外封测成本亦还是公司主要的成本。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，封测产能紧张，公司向封测厂商的采购的封测价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

#### 5、市场竞争风险

在国家产业政策的引导和支持下，我国集成电路设计行业取得了较快发展，

广阔的市场空间吸引了国内外众多集成电路设计公司进入此领域。公司目前产品主要为 LED 显示驱动芯片、LED 照明驱动芯片、电源管理芯片，相关芯片领域竞争激烈。未来随着众多集成电路设计厂商的进入，公司产品将面临更加激烈的市场竞争，对公司经营业绩产生不利影响。

#### 6、客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户销售的金额分别 19,557.83 万元、19,907.22 万元和 25,818.12 万元，占当期营业收入的比例分别为 48.14%、50.90% 和 55.77%，客户集中度较高。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果未来公司主要客户的经营、采购战略产生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。

#### 7、人才引进不足及流失风险

集成电路设计行业属于智力和技术密集型产业，高端、专业人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础。一方面，公司已拥有一支成果转化高效的高质素研发团队，团队成员整体稳定，但随着公司经营规模的快速发展，尤其是募投项目实施之后，公司对于高素质、专业化的优秀技术人才、管理人才、销售人才的需求将进一步增加。另一方面，公司针对优秀人才实施了多项激励措施，以稳定公司技术人才，但随着行业竞争日益激烈，同行业公司仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或公司受其他因素影响导致公司存在技术人员流失的风险。如果公司未来专业人才不能及时引进或既有人才团队出现大规模流失，将对公司经营产生不利影响。

#### 8、产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系，但由于芯片产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品质量的缺陷。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

## 9、知识产权风险

公司自成立以来一直坚持自主创新的研发策略，已申请多项发明专利、集成电路布图设计等一系列知识产权，这些知识产权对本公司经营具有重要作用。考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司知识产权的情况仍然有可能发生，而侵权信息较难及时获得，且维权成本较高，进而对公司正常业务经营造成不利影响。

同时，公司自成立以来一直坚持自主创新的研发策略，避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展，以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素出现非专利技术侵犯第三方知识产权的风险。

### （三）财务风险

#### 1、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 1,408.59 万元、2,417.52 万元和 2,085.19 万元，占存货账面余额的比例分别为 14.31%、17.88%和 20.24%，存货跌价准备余额较大。为了保证供货的及时性和连续性，集成电路设计企业通常需要提前向晶圆厂预定产能，提前进行备货，受研发结果、产品性能提升及市场竞争等因素的影响，一旦产品更新换代或者新产品未满足市场需求，未使用的原材料及未及时出售的库存商品就可能出现滞销的情况，导致形成大额存货跌价准备。公司产品技术更新换代速度较快，如果未来出现由于公司未能及时把握下游行业变化、未能及时加强对存货的管理或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，或其价格出现迅速下跌的情况，可能导致存货可变现净值低于成本，公司存在存货跌价的风险。

#### 2、毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 32.43%、30.46%和 30.44%，略有下降。公司主营业务毛利率主要受产品售价、原材料及封装测试成本、产品结构及公司设计能力等多种因素的影响，若上述因素发生不利变动，或者公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司主营业务毛利率出现下降的风险。

### 3、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受税收优惠的金额分别为 928.55 万元、535.04 万元和 911.40 万元，占当期利润总额的比例分别为 10.92%、10.53%和 10.40%，均为重点集成电路设计企业所得税税收优惠。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）以及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）文件，公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，2017 年和 2018 年公司执行 10%的优惠税率。2019 年度公司按照 10%的优惠税率预缴企业所得税。

如果未来国家对集成电路产业企业的税收优惠政策发生变化，或公司无法持续享受企业所得税优惠政策，则可能因所得税税率的变动对公司经营业绩产生不利影响。

### 4、政府补助变化风险

公司所从事的集成电路产品设计业务受到国家产业政策的鼓励和支持。报告期内，公司计入当期收益的政府补助金额分别为 1,094.92 万元、779.37 万元和 833.23 万元，占当期利润总额的比例分别为 12.88%、15.34%和 9.51%，对公司盈利能力影响程度整体减弱。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，可能会对公司当期净利润产生不利影响。

## （四）内控风险

### 1、实际控制人控制的风险

公司实际控制人为王乐康。截止本招股说明书出具之日，王乐康直接或间接控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的 69.87%。本次成功发行后，王乐康仍直接或间接支配公司 52.40%的表决权，能够通过股东大会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照真实意愿选举公司董事和间接挑选高级管理人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动，以及对公司章程的修改等行为，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。

## 2、管理风险

本次发行完成后，随着募投项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，员工人数、新产品研发数量将相应增加，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。如果公司的经营管理不能满足经营规模扩大对公司各项管理制度的要求，将会对公司的生产经营和盈利能力造成不利影响。

### （五）与本次发行相关的风险

#### 1、发行失败风险

公司本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式实施，会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的影响。在股票发行过程中，若出现有效报价或网下申购的投资者数量不足、发行后总市值未达到招股说明书所选上市标准等情况，可能会导致发行失败。

#### 2、募集资金投资项目不及预期的风险

公司本次募集资金主要用于智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目、集成电路封装项目、研发创新中心建设项目和补充流动资金。若公司本次募集资金投资项目能够顺利实施，将进一步增加公司的研发实力，提升现有产品性能，有助于扩大经营规模，提升公司的盈利能力和市场竞争力。公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，具有良好的市场前景和经济效益。但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益，因而本次募集资金投资项目存在投资效益不及预期的风险。

#### 3、新增固定资产折旧的风险

本次募集资金投资项目将增加公司研发和生产设备投入，募投项目建成后，公司固定资产将有一定程度的增加，每年固定资产折旧也将相应的增加，若募投项目未能达到预期收益水平，则将对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### 4、净资产收益率下降和即期回报被摊薄的风险

本次发行成功后，公司的总股本和净资产将会相应增加，而募集资金投资项目有一定的建设周期，且产生效益尚需一段时间，因此募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

#### **（六）新型冠状病毒肺炎疫情引发的风险**

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司曾受到延期开工以及物流不畅通的影响。同时，因新型冠状病毒疫情的影响，全球经济增速中短期内有所下滑，并由此给企业和居民的收入造成了影响。企业和居民收入的下滑可能会影响其对公司终端生产客户的产品消费，导致下游客户生产意愿不足，进而减少对公司产品的需求。若本次新型冠状病毒疫情的全球影响在中短期内不能得到有效控制，则将对公司的中短期经营业绩产生不利影响。

### **四、发行人的发展前景评价**

发行人自 2003 年设立以来，一直从事集成电路的研发及设计，发行人的发展经历过时间的考验，技术积累较多，拥有较多的专利及集成电路布图设计，在产品迭代上能够跟上市场的需求。

经审慎核查，本保荐机构认为，发行人的主营业务平稳发展，成长性好，所处行业发展前景广阔；公司在行业具有较高的品牌知名度和市场地位，公司未来发展具备良好基础；同时，发行人具有较为突出的竞争优势，并且募集资金投资项目的实施将进一步巩固和扩大发行人的竞争优势，发行人未来发展前景良好。

### **五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论**

受发行人委托，中信建投证券担任其本次公开发行并在科创板上市的保荐机构。中信建投证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐机

构内核部门的审核。保荐机构对发行人本次发行的推荐结论如下：

发行人本次首次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票的条件；募集资金投向符合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信建投证券同意作为明微电子首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

（以下无正文）



(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 张莉

张莉

保荐代表人签名: 龙敏 余皓亮

龙敏

余皓亮

保荐业务部门负责人签名: 吕晓峰

吕晓峰

内核负责人签名: 林煊

林煊

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

保荐机构总经理签名: 李格平

李格平

保荐机构法定代表人签名: 王常青

王常青

中信建投证券股份有限公司



2020年4月23日

附件一：

## 保荐代表人专项授权书

本公司授权龙敏、余皓亮为深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，履行该公司首次公开发行股票尽职尽责推荐和持续督导的保荐职责。

特此授权。

保荐代表人签名： 龙敏      余皓亮

龙 敏

余皓亮

保荐机构法定代表人签名： 王常青

王常青

中信建投证券股份有限公司

2020年4月23日

